



北方邦半导体政策 2024

北方邦政府 IT 与电子部

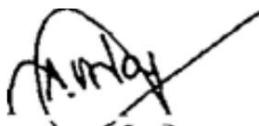
DISTINATION UTTAR PRADESH

Invest in BIDA



内容

前言.....	3
政策的愿景和目标.....	4
想象.....	4
2.2 政策目标.....	4
治理.....	4
3.1 节点代理.....	4
3.2 政策执行单位 (PIU).....	5
3.3 授权委员会 (EC).....	5
政策实施和覆盖范围.....	5.4.1 保单期限和承保范围
围.....	5
4.2 资格标准.....	5
4.3 条款和条件。.....	6
5. 批准和支付.....	7
5.1 审批流程.....	7
5.2 补贴的发放.....	7
6. 激励措施。.....	7
6.1 财政激励措施.....	7
6.2 非财政激励措施.....	9
7. 申请流程.....	11
8. 术语表.....	12
9. 缩写.....	16

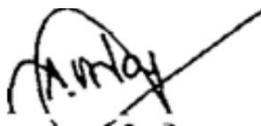


1序言

半导体制造对于各行业的现代进步至关重要。提高智能手机、计算机和医疗设备等设备的效率。它还刺激了人工智能、物联网和量子计算领域的创新。从经济上讲,它通过复杂的供应链促进就业和增长,而投资则确保技术主权和全球竞争力。在这个数字时代,半导体推动创新。互联互通、繁荣。

印度半导体使命旨在将印度打造成全球半导体大国。该使命以本地生产、R&D 和减少进口依赖为重点,促进创新和先进的就业机会。通过改善基础设施、促进合作和培养技术工人,该计划提高了印度的技术自主权和在半导体和电子领域的全球地位。这符合印度对数字卓越和对全球半导体格局做出重大贡献的渴望。

北方邦是一个快速增长的经济体,约占全国 GDP 的 9%,与印度政府的愿景一致,致力于培育该邦内的半导体生态系统。这一努力旨在加速电子制造和创新的扩张它与印度成为 1 万亿美元 (USD) 经济体的雄心相一致,从而与总理阁下推动印度迈向 5 万亿美元 (USD) 经济体的总体目标相一致

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Ajay' or similar, with a long horizontal stroke extending to the right.

政策的愿景和目标

2.1 愿景

通过提供具有全球竞争力的基础设施和有利的政策环境,将北方邦打造成半导体行业的首选目的地,通过有效利用技术力量、适应创新和新兴技术,将半导体制造业培育为北方邦的重要增长动力,从而实现全面可持续发展生态系统从而为国家和民族经济的整体增长做出贡献。

2.2 政策目标

北方邦半导体制造政策的主要目标如下:

- 在北方邦建立强大的半导体制造生态系统,以推动该邦的经济增长,促进创新,创造大量就业机会,并增强印度在具有重要战略意义的领域的自力更生。
- 开发配备先进设计和测试工具的尖端基础设施,促进初创企业之间的协作。企业和教育机构释放其最大潜力。
- 在州内培育支持性的无晶圆厂生态系统,重点是针对芯片设计企业和初创企业。
- 在工业界和学术界之间建立牢固的联系
通过课程改进、电子教育定期更新以及通过州技能发展任务促进主要技能建设研讨会来培养技术人才库。
- 为中长期内有利于潜在制造单位建立的环境铺平道路,同时强调半导体设计和制造工艺的更高附加值。

3. 治理

3.1 节点代理

UP电子有限公司为该部下属节点机构

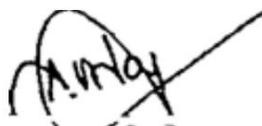
政府 IT 与电子部门北方邦将负责

有效实施《2024 年北方邦半导体政策》。

该机构应负责为该州半导体生态系统的持续增长创造有利的政策环境。它磨坊

充当与所有生态系统利益相关者互动的单一窗口。为了管理单一窗口运营,节点机构将设立一个专门的

项目管理部门 (PMU)配备了充足的外包专业人员和顾问来支持政府。



3.2 政策执行单位 (PIU)

由首席秘书/附加首席秘书担任主席的PIU。应设立IT与电子部来监督Hoda\ Agency的工作。PIU 应负责有效实施本政策,包括向授权委员会提出建议。PIU负责审查投资提案并向授权委员会提出必要的批准。

该委员会由 ACS/PS 提名的来自工业发展部、国家税务部、印花税和注册部、信息技术与电子部的成员组成。财政部、住房部、劳工部,并根据需要可能包括其他部门/工业发展机构等的成员。

3.3 授权委员会[EC]

应设立由布政司担任主席的国家级授权委员会,以监督该政策的有效实施。委员会章程应涉及有效执行政策和部门间协调,及时解决各级投资者问题。根据该政策申请的所有项目都将根据授权委员会的建议获得内阁批准。

该委员会由工业发展部、国家税务部、信息技术与电子部、财务部、规划部、小型工业部的 ACS/PS 组成。商业税、能源部、灌溉部、住房部、劳工部,并可根据需要可包括其他部门的首席秘书/首席秘书/工业发展机构的首席执行官等。

根据该政策组建的授权委员会应就该政策的扩展/修订做出决定。

4. 政策实施及覆盖范围

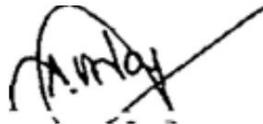
4.1 保单期限和承保范围

UP-Semiconductor 2024 政策的有效期为自通知之日起五 (5) 年。
该政策覆盖全州。自政策通知之日起允许投资。

受益于该计划的实体必须承诺自整个项目商业生产开始之日起至少维持其商业生产运营三年,并需要为此提供正式承诺。

4.2 资格标准

已获得印度政府印度半导体使命 (ISM)以下任何计划资格的项目将符合本政策的资格。

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Anil', with a long horizontal line extending to the right.

4.1.1 印度半导体工厂设立方案

4.1.2 印度显示器工厂设立方案

4.1.3 在印度建立化合物半导体/硅光子传感器工厂和半导体组装、测试、标记和封装 (ATMP) / OSAT 设施的计划。

4.1.4 任何其他正在修订或提议的类似方案
印度政府。

4.1.5 根据设计相关激励措施批准的项目或与无晶圆厂活动相关的项目不符合本政策的资格,但是,投资者可以根据 2022 年 UP IT/LTES 政策申请并享受福利。

4.2 合格投资

4.2.1 半导体晶圆厂:FiSCdl 支持占项目成本的百分比应仅限于印度政府 Meity 发布的《印度半导体晶圆厂修改方案指南》第 2.12 节中定义的活动 2023 年 5 月 29 日,不时修订。(术语表 8(ii))

4.2.2 显示工厂:财政支持占项目成本的百分比应仅限于印度政府 2023 年 5 月 29 日发布的《印度设立显示工厂修改计划指南》第 2.12 节中定义的活动,如下:不时修改。(术语 6(ii))

4.2.3 ATMP/OSAT:财政支持占资本支出的百分比应受到限制
印度政府 Meity 于 2023 年 6 月 30 日发布的《在印度建立 ATMP/OSAT 设施的修改方案指南》第 2.1.1 节中定义的活动(经不时修订)。(术语表 8(iii))

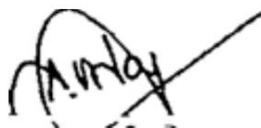
条款及条件

该政策不能与该州的任何其他政策/计划相吻合。但与印度政府的计划/政策相衔接是允许的。除了印度政府任何计划/政策下提供的激励措施之外,还可以利用本政策中指定的所有激励措施。政府提供的激励/补贴将受到印度政府批准的合格项目总成本的 100% 总体上限的限制。

已计入修改方案下拟议项目的项目成本中的资本支出或投资,用于建立各种半导体相关设施。包括半导体标签。显示工厂、化合物半导体/硅光子传感器工厂、半导体组装、测试、印刷和包装 (ATMP)。根据通知 CG-DL-E-04 102022-239339 da (编辑 04.

10.2022,CG-DL-E-06102022-239340

日期为 2022 年 10 月 4 日的保险和日期为 2023 年 6 月 9 日的 CG-DL-E-1006Z023-246449 将仅有资格获得资本补贴,而不能获得保单中概述的任何其他福利。



4. 审批与支付

4.1 审批流程：

提交的提案涵盖半导体实验室、显示器制造、化合物半导体、硅光子学 (SiPh)、传感器 (包括MEMS) 工厂。印度的分立半导体工厂以及半导体组装、测试、标记和封装 (ATMP)/外包半导体组装和测试 (OSAT) 工厂已获得印度半导体使命 (ISM) 政府的认可,并且正在建设中在北方邦内推行的计划将被送交邦内阁批准。尊敬的国内阁的批准将根据授权委员会提供的建议进行。

GoUP 批准流程:提案已获得印度政府印度半导体代表团的认可,并寻求在北方邦建立半导体设施 (如 4.2.1、4.2.8 和 4.2.3j 中所定义),将获得LoC,但条件是批准的奖励不超过合格项目总数的 100% / ISM批准的成本和签发的LoC只有在印度政府批准提案后才会生效。

- 申请人需要同时根据UP-Semiconductor 2024年政策进行申请
同时向印度半导体代表团提交提案

4.2 补贴发放

资本激励是除印度政府提供的激励之外的一项。只有当印度政府向投资者释放其份额后才会进行支付,并且支付将以 Pari Passu 模式进行。

所有其他财政激励措施。除资金补贴外,投产后可享受政策规定的土地成本回扣、印花税和登记费减免等优惠。

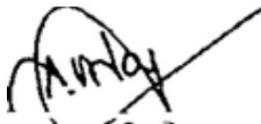
6 激励措施

该政策提供的财政激励措施超出了印度政府提供的激励措施。但是,除非政策中另有说明,单位要求的所有来源的激励措施包括印度政府提供的激励措施。不得超过合格项目成本的 100% (如本政策第 4.3 条所定义)。

6.1 财政激励

6.1.1 资金补贴:经印度政府批准的资金补贴的50%。该福利将根据印度政府以 Pari-Passu 模式提供的福利进行支付。

6.1.2 利息补贴:对于从指定银行/金融机构获得的贷款投资金额不超过 INR 200 Cr 的单位,每年可享受 5% 的利息补贴 (按利率计算),最高可偿还 INR 1 Cr 每年每单位 7 年 (每单位最高 INR 7 Cr)



D. 补贴将在项目获得批准后分期提供,每期 50%,批准后 3 年后提供 25%,最后 5 年实现承诺成果后提供 25%。

6.1.1 卓越中心 (CoE):

政策设想以卓越中心 (CoE)的形式创建世界一流的基础设施,以促进半导体领域的研究和创新。政策旨在与知名学术机构和/或行业协会/行业或任何其他政府/私人实体合作建立卓越中心。CoE 项目总成本中最多 505 美元 (最多 10 Cr)将由 UP 政府承担

公司只需考虑第 6.1.9 或 6.1.10 段中的一种选择,即可以利用建立研发中心或卓越中心的补贴

6.1.2 专利注册费的报销: 。

专利注册费用应按 75% 的比例报销 (一次性),获得国内专利的费用最高为 10 卢比,一次性获得国际专利的费用最高为 200 万卢比。

6.1.3 工业用房:

单位房舍半径 10 公里内的工人住房/宿舍及相关集体设施开发成本的 10% 或 1 亿印度卢比 (以较低者为准)将分 7 次每年等额分期提供。

6.2 非财政激励

6.2.1 关键任务基础设施:该州的半导体行业应根据基本服务和维护法案 (ESMA) 归类为基本服务提供商。

6.2.2 供水:州政府。将确保项目现场半导体装置的供水。

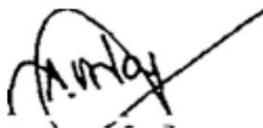
6.2.3 应允许单位通过开放通道获取电力。

6.2.4 应向单位提供可再生/绿色能源的电源库,并按照国家电力监管委员会 ERC 指南进行管理。

6.2.5

6.2.6 政府将确保电网有足够的冗余,为FAB项目的无缝运行提供可靠的电力保障。

6.2.6 无干扰规定:为了提供有保证的业务连续性。一旦开发商完成投资并获得相关管理局的竣工证书并全额支付租赁租金,如果管理局的此类半导体单位有任何违规行为,则必须获得第八届管理局的批准才能取消租赁契约。规范/章程。



6.2.7 三班倒经营:半导体单位应允许进行每周 7 天、每天 24 小时的经营,并在所有三班制中雇用女性,但单位应采取必要的预防措施,确保女员工的安全和保障。

6.2.8 自我认证:根据以下法案和规则,半导体单位免于接受检查,除非因具体投诉而进行检查。这些单位可以按照规定的格式提交自我证明:

- 工厂法 · 生育福利法
- 商店和场所法

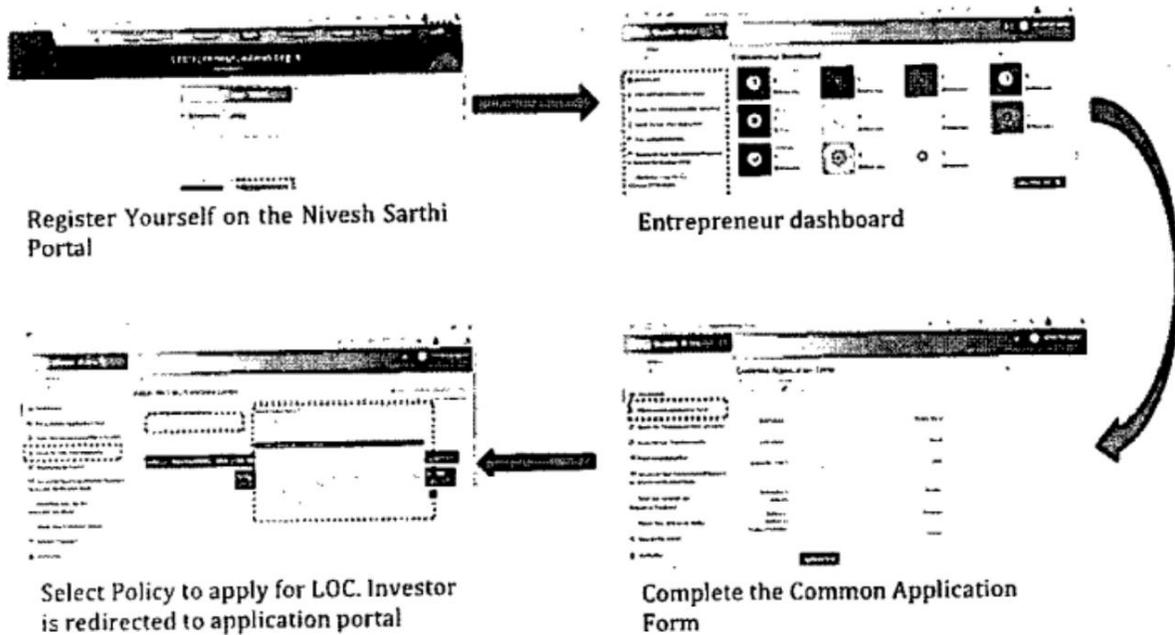
- 《合同工 (监管和废除)法》 · 《工资支付法》 · 《最低工资法》

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. M. J.', with a long horizontal line extending to the right.

七、申请流程

Nivesh Mitra 是北方邦的单一窗口门户 (<https://niveshmifra.up.nic.in/>),是一个可简化业务流程的一体化在线平台。它允许在线申请、文件上传、费用支付、实时状态跟踪和数字签名的 NOC。它负责签发必要的许可、许可证、LOC 和 NOC,用于预设立、预运营、续签以及在北方邦开办和经营企业所需的其他证书。

申请人必须使用 Nivesh Mitra 门户提交提案,然后该提案将引导他们进入在线激励管理系统。在这里,他们需要提交与项目相关的基本提案细节和文件,以便根据 UP-Semiconductor 2024 年政策向 IT 和电子部门申请安慰信 (LOC)。



(Handwritten signature)

8. 术语表

半导体制造:制造用于各种电子产品的半导体器件的过程。

我。设立半导体和显示器工厂的合格资本投资:如《设立半导体工厂的修改方案指南》(通知编号 CG-DL-E-06102022-239339)和《设立半导体工厂的修改方案指南》第 2.12 节所述。 Display Fab (通知号 CG-DL-E-06102022-239340) 文件号

W-38/21/2022/PHW 日期为 2022 年 5 月 29 日

项目成本应包括资本支出/投资

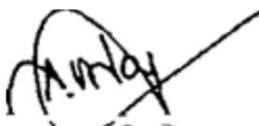
- 土地、建筑物、厂房、机械、洁净室、设备。和相关公用事业
- 研究与开发技术转让
- 其他相关成本,例如施工期间的利息和
保险费用

三.设立化合物半导体/硅光子/传感器工厂/分立半导体工厂和半导体 ATMP 和 OSAT 的合格资本投资:如《设立化合物半导体/硅光子/传感器工厂/分立半导体修改方案指南》第 2.1 1 节所述印度的半导体工厂和半导体组装、测试、标记和封装 (ATMP)/外包半导体组装和测试 (OSAT) 设施 (以下简称“计划”)

已收到通知,编号为 CG-OL-E- 06102022- 239341,日期为 2022 年 10 月 4 日,已修订,参见通知号 CG-DL-E- 100620Z3-

246449,日期为 09.06.2023,文件号 W-38/2 1/2022/IPHW,日期为 2023年6月30日

- 建筑、厂房、机器发生的资本支出/投资。干净的
- 房间、设备和相关公用设施
- 研究和开发所产生的资本支出/投资
开发人员((R&D)
- 与技术转让相关的资本支出/投资
(ToT) 协议



- 项目/单位所需土地所产生的支出不应计入该计划下的合格资本支出/投资计算中。

印度半导体使命 (ISM) :印度半导体使命四。

印度政府电子和信息技术部 (MeitY) 下属的数字印度公司 (ISM) 是实施半导体和显示器制造生态系统开发计划/修改计划的节点机构。

在。 节点机构:负责监督的主要政府组织

北方邦半导体政策的实施。

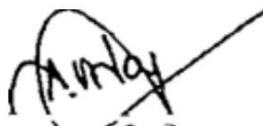
六.政策执行单位 (PIU) :由首席秘书/附加首席秘书担任主席的专门单位; IT与电子部负责监督节点机构的工作。

七.授权委员会 (EC) :由布政司担任主席的国家级委员会,负责监督政策实施和部门间协调。

八.印度电子和信息技术部 (Meit YN) 于 2022 年 10 月 4 日通过公报公告编号 CG-DL-E-04102022-239339 通报了印度半导体工厂的修改方案。

修改后的计划为 SOA 在印度设立半导体工厂的项目成本提供财政支持。项目成本包括土地、建筑物、厂房、机械、设备和相关公用设施的成本。申请获得批准后,财政支持将在同等基础上提供,但须遵守计划指南和批准函中规定的条款和条件。

九.印度电子和信息技术部 (Meit Y) 于 2022 年 10 月 4 日通过公报公告编号 CG-DL-E-04102022-239340 通报了印度显示器工厂的修改方案。修改后的计划为在印度设立显示器工厂的项目成本提供了50克的财政支持。项目成本包括 (土地、建筑物、厂房、机械、设备和相关的成本)

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. M. Dey', written over a horizontal line.

公用事业。申请获得批准后,财政支持将在同等基础上提供,但须遵守计划指南和批准函中规定的条款和条件。

X.印度电子和信息技术部 (MeitY) 于 2022 年 10 月 4 日通过公报公告编号 CG DL-E-06102022-239341 通报了印度化合物半导体和 ATMP 设施的修改方案。印度化合物半导体和 ATMP 设施的修改方案为建立化合物半导体/硅光子/传感器工厂/分立半导体工厂和半导体组装、测试、标记和封装 (ATMPJ/外包半导体)提供了 50 美元的资本支出财政支持印度的组装和测试 (OSAT) 设施。

化合物半导体:由元素周期表中不同族的两种或多种元素形成的半导体材料。

显示器制造:制造电子显示器所用的显示器的过程

设备。

无晶圆厂生态系统:专注于半导体芯片设计和开发的生态系统,无需内部制造设施。

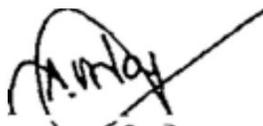
安慰函 tLoC}:一种金融工具,用于向一方保证发行人将履行其义务。

十五. Pari Passu:Nodal Agency 按比例付款将在申请人/项目公司和其他人调动相应份额后释放

十六.无干扰条款:通过要求董事会批准因违反政策而取消租赁来确保业务连续性的条款。

十七.外包半导体组装和测试 (OSAT) 设施:提供半导体封装和测试服务的设施。

十八.半导体制造 (FAB):制造半导体器件的过程。也称为半导体制造。

A handwritten signature or mark, possibly reading 'A.M. Jay', written in black ink.

十九.半导体光子学:半导体技术的分支,涉及使用光子(光粒子)进行信息处理和传输。

xx.经济特区(SEZ):商业和贸易法律与该国其他地区不同的指定区域,旨在吸引投资和促进出口。

XXi 资本补贴:政府提供的财政援助,用于降低半导体制造项目的资本成本。

xxii 印花税:对法律文件征收的税,特别是与土地购买或租赁相关的法律文件。

xxiii.电力补贴:降低半导体制造单位电力成本的财政激励措施。

二十四.电力税:对电力消耗征收的税。

二十五.双电网网络:冗余供电基础设施,确保半导体工厂不间断供电。

二十六.输电和转运费用:与输电和配电相关的成本。

二十七.基本服务和维护法案 fESMA7:立法指定了某些

工业或服务至关重要,确保其不间断运行。

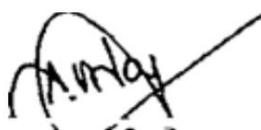
二十八.开放获取:单位直接从电网或其他供应商购买电力的能力。

xxix.电力银行:能够存储多余的可再生能源并在需要时使用它。

xxx.个案基础:根据具体情况单独做出决定。

xxxi.自我认证:单位无需外部检查即可声明遵守某些劳动法的过程。

三十二.银行/金融机构:应考虑所有指定银行。所有受印度储备银行监管和批准的金融机构均应予以考虑。

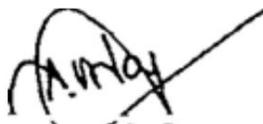
A handwritten signature or mark, possibly reading 'A. m. d. y.', written in black ink.

9. 缩略语

- AI - 人工智能
- ATMP - 组装、测试、标记和包装
- EC - 授权委员会
- EMC - 电子制造集群
- ESDM - 电子系统设计 & 制造
- FCI - 固定资产投资
- GOI - 印度政府
- IoT - 物联网
- IT - 信息技术
- ISM - 印度半导体使命
- MeitY - 电子信息技术部
- OSAT - 外包组装测试
- PIU - 项目实施单位
- PMU - 项目管理单位
- SEZ - 经济特区

免责声明本“2024

年北方邦半导体政策”文件是从印地语原文翻译而来,纯粹是为了方便非印地语用户并扩大影响范围。尽管我们已尽最大努力确保翻译的准确性,但如果对本文中提供的条款的解释存在任何差异,则以刊宪的“原始”印地语版本为准。

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. M. Dey', with a long horizontal line extending to the right.